

檔 號：113/200502/

保存年限：5年

：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：裝
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：訂
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：線
：

便簽 日期：中華民國113年5月20日
單位：推廣教育組

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

- 一、本案係國立臺北科技大學與明新科技大學半導體學院合作辦理113年「半導體封裝測試工程師人才培育計畫」課程招生資訊。
- 二、文陳閱後存查並轉知本組同仁參閱。

1130506460

國立臺北大學



推廣教育組

1130506460

會辦單位：

第二層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
<p>組員 高玉瑄 0520 1510</p> <p><small>副教授兼任 推廣教育組組長</small> 吳雪伶 0521 0926</p> <p>秘書 林佑亮 0521 1235</p>		<p>如擬</p> <p><small>教授兼任進修整 推廣部主任</small> 陳國華 0521 2127</p>

裝

訂

線

1130506460

檔 號：

保存年限：

國立臺北科技大學 函

機關地址：106344臺北市大安區忠孝東路
三段一號

承辦人：盧亮廷

電話：02-2771-2171#6020

電子信箱：hund@mail.ntut.edu.tw

受文者：國立臺北大學

發文日期：中華民國113年5月16日

發文字號：北科大產學字第1137900101號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：113年半導體封裝測試工程師人才培育計畫課程表(附件1 113F900374_1_16150332731.pdf)

主旨：檢送本校與明新科技大學半導體學院合作辦理113年「半導體封裝測試工程師人才培育計畫」課程資訊（詳如說明），敬邀貴校學生踴躍報名參加，並請協助公告，請查照。

說明：

- 一、近年來AI、5G、物聯網等新興產業為半導體產業帶來大量就業機會，然而產線作業和管理人才供不應求。本課程將透過實務操作來培養學生對於封裝測試之能力，以期未來可投入相關產業，補上半導體封裝測試人才需求。
- 二、報名資格：國內各大專校院之在學學生。
- 三、課程時間：113年6月1日（六）、6月2日（日），共計2天，凡全程參與課程，且符合報名資格者，將於課程結束後將核發研習時數證明。
- 四、課程地點：明新科技大學逢喜樓209教室及半導體人才培育基地（新竹縣新豐鄉新興路1號）。
- 五、人數上限：25人（皆為實體上課）。
- 六、報名時間：即日起至113年5月28日（二）17點為止（如人數額滿將提前截止）。



國立臺北大學

第1頁，共3頁
線上簽核文件列印 - 第3頁/共5頁



1130506460 113/05/16

裝

訂

線

- 七、報名網址：<https://forms.gle/r8zg7zDHwV88wPGA7>
- 八、交通接駁：課程兩天提供接駁車往返臺北車站及上課地點，報名者亦可選擇自行往返。欲搭乘接駁車者，請於課程兩日早上7:30至8:00在臺北車站東三門集合，8:00準時出發前往上課地點，兩日課程結束後由課程地點接駁至臺北車站。
- 九、活動聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學盧專員，連絡電話:(02)2771-2171分機6020，電子郵件：hund@mail.ntut.edu.tw。
- 十、檢附「半導體封裝測試工程師人才培育計畫」課程表。

正本：各公私立大專校院

副本：明新學校財團法人明新科技大學半導體學院張合院長、明新學校財團法人明新科技大學半導體學院趙守嚴副院長、力成科技股份有限公司何信松資深工程師、力成科技股份有限公司林賢昇資深工程師、力成科技股份有限公司黃志賢資深工程師、本校產學合作處

113/05/16
15:27:16

113 年「半導體封裝測試工程師人才培育計畫」課程

日期：113 年 6 月 1 日（六）和 113 年 6 月 2 日（日）

地點：明新科技大學逢喜樓 209 教室及半導體人才培育基地（新竹縣新豐鄉新興路 1 號）

時間：09:30~18:30（報到時間 09:00~09:30，中午休息時間 12:30~13:30）

人數：25 人（皆為實體，無線上授課）

活動內容：



報名連結

日期	時間	課程名稱	授課教師	地點
6/1 (六)	09:00~09:20	報到		明新科技大學 逢喜樓 209 教室
	09:20~09:30	致詞	明新科技大學 半導體學院 張合院長	
	09:30~12:30	半導體製程概論	明新科技大學 半導體學院 趙守嚴副院長	
	12:30~13:30	午餐		
	13:30~17:30	晶圓切割機操作實務	力成科技股份有限公司 何信松 資深工程師	
	17:30~18:30	Q & A		
6/2 (日)	09:00~09:30	報到		明新科技大學 半導體人才培育基地
	09:30~12:30	黏晶機操作實務	力成科技股份有限公司 林賢昇 資深工程師	
	12:30~13:30	午餐		
	13:30~17:30	打線機操作實務	力成科技股份有限公司 黃志賢 資深工程師	
	17:30~18:30	Q & A		

備註：

1. 本次研習課程為期 2 天，需參與全程課程，且符合報名資格者（全國各大專校院在學學生），將於課程結束後核發研習時數證明。
2. 填寫並提交課程報名表單後即可視為報名成功，若後續因報名資格不符或額滿等因素而無法錄取，主辦單位將提前另外以 Email 通知。
3. 主辦單位保留報名資格審核權，修改或變更活動內容及額滿提前截止報名之權利。
4. 本研習為免費課程，報名者無須負擔報名費。
5. 6/1（六）和 6/2（日）兩天將於課前和課後提供交通接駁往返臺北車站及上課地點，請於報名表單中填寫是否搭乘接駁車。

活動聯絡人：教育部產學連結執行辦公室-國立臺北科技大學 盧專員

連絡電話：(02)2771-2171 分機 6020，E~mail：hund@mail.ntut.edu.tw